

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023- 037

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，考虑宏观经济影响，并结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“年产180万片集成电路用12英寸硅片”、“年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

一、公司2021年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为91.63元，募集资金总额5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，公司实际募集资金净额为5,152,183,274.35元。公司本次发行募集资金已于2021年10月8日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	346,005.00	228,800.00	207,715.66
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	80,259.00	78,422.00	68,050.44
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	66,101.00	62,778.00	60,989.29
4	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	145,347.16
合计		642,365.00	520,000.00	482,102.56

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

(一) 本次延期的募集资金投资项目情况

1. 公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间	
		调整前	调整后
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	2022 年 12 月	2023 年 12 月
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	2022 年 8 月	2023 年 12 月

2. 截至调整前项目达到预定可使用状态时间，前述延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	截至项目达到原预定可使用状态时间募集资金已累计投入金额	截至项目达到原预定可使用状态时间募集资金已累计投入进度
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	346,005.00	228,800.00	207,715.66	90.78%
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	80,259.00	78,422.00	55,061.50	70.21%

(二) 本次募集资金投资项目延期原因

公司受外部宏观经济环境影响，项目建设进度有所延迟，同时因部分进口设备交货周期延长，整体建设进度未达预期。且因项目整体建设周期较长，从 2022 年第三季度开始，公司所处

行业市场景气度逐渐偏弱，导致市场需求下降。为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将上述项目完成期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

（三）募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率、保障募集资金投资项目的顺利实施及维护全体股东的利益，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况决定的，仅涉及该项目进度的变化，不存在损害公司股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司对募集资金投资项目延期。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月25日